

# セル生産用静止型リフロー装置・RDT-250C

鉛フリー基板のプロファイル評価に最適！  
専用ソフトにより加熱条件の合否判定が可能！

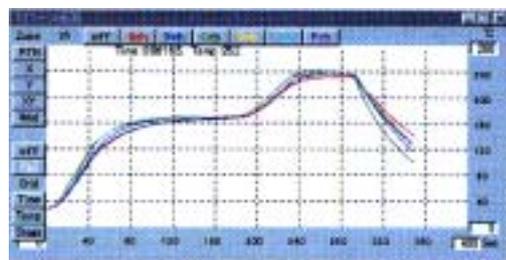
## 特徴

新開発の上面熱風マトリクス制御により、実装基板で  $t_5$  を実現。  
鉛フリーハンダ実装に理想的な台形プロファイル加熱が簡単に出来ます。  
コストパフォーマンスに優れていて低消費電力の装置です。

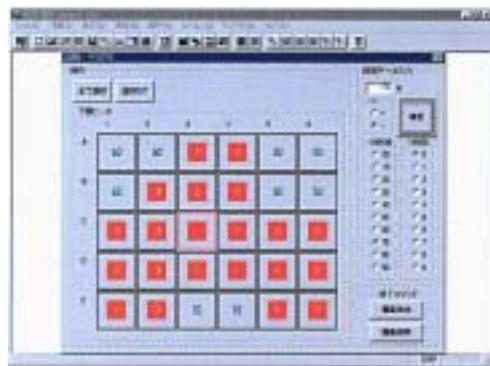


鉛フリー (Sn-3.0Ag-0.5Cu)  
に適した台形温度プロファイル

項目	仕様
対象基板	250W × 330Lmm以下 高さ 保持面上下共15mm以下
装置寸法	830W × 557D × 523Hmm
加熱方式	上面:熱風・遠赤外線輻射併用 下面:遠赤外線輻射
冷却方式	外部ガス(窒素または空気)導入による(排気ダンパ連動) 冷却用流量調整弁付き
電源	3相 200V 50/60Hz 18kVA
外部ガス	0.3 ~ 0.5MPa 100ℓ / min (MAX)
炉内酸素濃度(窒素使用時)	最低100ppm
基板トレイ	ネット式またはキャリア式(いずれか選択)
上面加熱	熱風・遠赤外線ヒータ:7.2kW(約240W × 30ブロック) 基準モジュールに対する偏差設定可能 熱風ヒータ :8kW(2kW × 4)
下面加熱	遠赤外線ヒータ:約2kW(330W × 6)
温度精度	常温 ~ 80 : ±3 80 ~ 330 : ±2
測定温度	常温 ~ 330
測定点数	6ポイント
窒素供給機能	流量調整弁:100ℓ / min
制御	RDT-250S 対応OS:日本語WindowsXP/2000
装置重量	約110kg

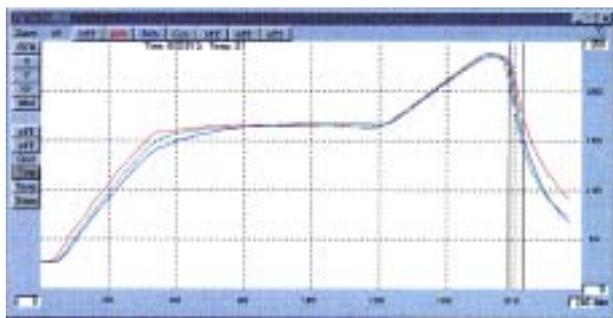


上面熱風マトリクス制御  
上面ヒータをブロックごとに独立制御する事で  $t_5$   
5 以内を実現しました。



## オートクーリングシステム

加熱終了後の基板を炉内から引き出す時間と温度の設定およびガス  
流量の調整により自在な冷却が可能となり、ひけ巣やリフトオフ等の  
不良に対する急冷効果を検証できます。



オートクーリングシステムを併用した急速冷却プロファイル



冷却が終了して基板を取り出す様子  
クーリングユニットはリフロー装置本体前面に取り付けられます。